



Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc.

暉盛科技股份有限公司 2026年法人說明會

2026年上半年營運成果暨
先進封裝電漿製程技術策略說明

日期：2026年6月22日

法人說明會 / 台北

資料性質：非公開投資說明文件

議程



01

公司簡介與核心競爭力



02

先進封裝產業趨勢與電漿製程技術



03

技術能力矩陣與發展路線圖



04

115年第一季財務成果



05

接單現況與市場結構



06

未來展望與投資價值



07

重要聲明

公司簡介與核心競爭力

暉盛深耕電漿（Plasma）乾式製程設備逾20年，專注於先進半導體封裝領域，致力於提供高效、環保且精密的製程解決方案。



IC 載板/先進封裝

ABF / BT 基板
AI 伺服器核心材料



面板級封裝

FOPLP 技術
大面積、高成本效益



晶圓級封裝

FOWLP 先進製程
異質整合關鍵技術



玻璃基板

Glass Substrate / TGV
下世代封裝主流

核心競爭策略

Dry Only

全乾式電漿製程
全面取代傳統濕式藥水製程

35+

客戶製程驗證
截至2026年5月
技術市場廣泛認可

49 筆

合計接單 + LOI
累計2026年5月
訂單量體有支撐

公司簡介與核心競爭力

01

◎ 市場切入點精準：卡位 AI 產業鏈核心

AI 伺服器 高端FCBGA/ABF 異質整合 玻璃基板

精準卡位半導體產業當前投資主軸，與 AI 算力建設規模正比成長。

02

🛡 技術進入門檻高：長期驗證建立護城河

電漿製程參數精密控制（孔徑、蝕刻速率、選擇比）需長期研發與客戶共同驗證，**驗證週期達 6-18 個月**，競爭者難以快速複製。

03

🔄 替代商機明確且具排他性：乾式取代濕式

多項應用目標以電漿完全取代藥水製程，一旦導入即形成穩定且具排他性的設備採購需求，**客戶轉換成本極高**，確保長期穩定訂單。

04

📈 收入後重前輕，訂單能見度高

大型客戶交機確認度高，下半年業績具備明確訂單支撐，增長趨勢明確。

先進封裝產業趨勢與電漿製程技術



AI/HPC 需求爆發

AI 伺服器與高效能運算晶片拉動高階 FCBGA、ABF 載板大幅擴產，需求呈正比成長。



異質整合加速

Chiplet、CoW、Hybrid Bonding 等先進技術快速導入量產，3D 堆疊成為主流架構。



線寬微縮挑戰

ABF 孔徑縮至 5~7 μ m、RDL 線寬持續下探，傳統濕製程藥水難以應對微小孔徑。



新基板崛起

玻璃基板 (Glass Substrate/TGV) 成為下世代主流材料，Intel、三星等大廠全力投入。



FOPLP 擴張

大尺寸 Panel 製程導入，提升封裝面積效益與成本競爭力，帶動大面積均勻製程需求。

CORE NECESSITY

電漿製程的不可取代性

✓ 精密除膠渣 (Desmear)

雷射鑽孔後的精密除膠，解決微小盲孔藥水深入困難與殘渣問題。

✓ 高精度蝕刻 (Advanced Precision Etching)

精準移除介電層與金屬薄膜，支援細線路製作及減薄蝕刻需求，實現高解析度圖形與優異尺寸控制。

✓ 表面去氧化與活化 (De-oxidation & Activation)

Hybrid Bonding 前去氧化與玻璃基板粗化，確保異質整合接合強度。

電漿的「乾式精密」特性使其能取代或補充傳統濕製程，大幅提升先進封裝的製程可靠度與良率。

先進封裝產業趨勢與電漿製程技術

先進封裝面臨線寬微縮與大面積均勻性挑戰，傳統濕式化學製程已達物理瓶頸。電漿乾式製程憑藉「奈米級精度」與「環保零廢液」特性，成為取代或補充傳統製程的必要選擇。

製程挑戰	傳統濕式製程的困難	電漿乾式製程的解法
線寬微縮	盲孔孔徑縮至 5~7μm，藥水張力導致難以均勻深入細微結構。	透過氣體離子化能精確控制蝕刻深度與選擇比，應對極細微孔。
大面積均勻性	載板擴大至 541×620mm，藥水流動不均導致蝕刻速率一致性難保證。	專利腔體設計確保大面積電漿分布一致，達成全板高均勻度。
環保與成本	強酸強鹼廢液處理成本持續上升，且面臨嚴苛環保法規限制。	全乾式製程零廢液排放，符合 ESG 趨勢並大幅降低廢棄物處理成本。

🔧 奈米級精度控制

技術指標：孔徑 5~7μm BUF 蝕刻，精確控制誤差至 1μm 以下，滿足 AI 晶片高密度布線需求。

🏠 大面積均勻製程

覆蓋範圍：支援從 8 吋晶圓到 541×620mm 大面積 MSAP 基板，具備極佳的製程穩定性與重複性。

🌐 跨材料兼容性

多元應用：廣泛兼容 ABF、BT、玻璃基板、Si Wafer 及 PI 薄膜，一站式解決多種先進材料處理難題。

技術能力矩陣與發展路線圖

製程技術類型	FOPLP 面板級	FOWLP 晶圓級	Glass / TGV	IC 載板 (ABF/BT)/先進封裝
Desmear 除膠渣	★	—	—	★
RIE 精密薄膜蝕刻	★	★	★	★
表面清潔 / 親水性	★	★	★	★
去氧化 / Ashing	★	★	★	—
Warpage / 應力釋放	—	★	★	—
★ 核心/量產應用 (Core / Mass Production)				

技術發展路線圖 (Roadmap)

2020-2024

基礎能力建立

- IC載板ABF Desmear量產
- FCBGA EOL清潔技術
- BT Desmear標準化奠基

2025-2026

先進封裝全面佈局

- Hybrid Bonding前處理
- 玻璃基板TGV突破性應用
- Power Module應力釋放

2026-2027

異質整合與標準化

- Chiplet電漿前處理標準化
- Glass Core量產製程建立
- 超大載板高速蝕刻系統

2027+

量產導入與前瞻展望

- Foveated Glass量產導入
- FOPLP大面積全製程方案
- Fluxless HB標準製程建立

115年第一季財務成果

115年 Q1 營業毛利率

46 %

↗ 較去年同期提升 4 個百分點 (YoY +4%pts)

📈 營業收入 (NT\$ K)

92,232 +10.9% YoY

✅ 營業利益 (NT\$ K)

11,150 扭虧為盈

💰 基本每股盈餘 (EPS)

0.37元 +363% YoY

115年第一季財務成果



營收穩健成長

92,232 **+10.9% YoY**

- 反映先進封裝電漿設備需求持續擴張。
- 客戶驗證轉量產訂單陸續落地。

114年Q1營收：83,131 (單位：新台幣千元)



毛利率顯著提升

46% **+4.0 pts**

- 產品組合優化，高單價 RIE 及高階設備佔比提升。
- 製程能力成熟，營業成本率由 58% 降至 54%。

114年Q1毛利率：42%



成功扭虧為盈

12% **+14 pts OP%**

- 費用控管成效顯著，推銷費用率由 14% 降至 8%。
- 營業利益 11,150 千元 (去年同期為虧損 1,339)。

研發費用持續投入，維持技術領先優勢



獲利能力大幅躍升

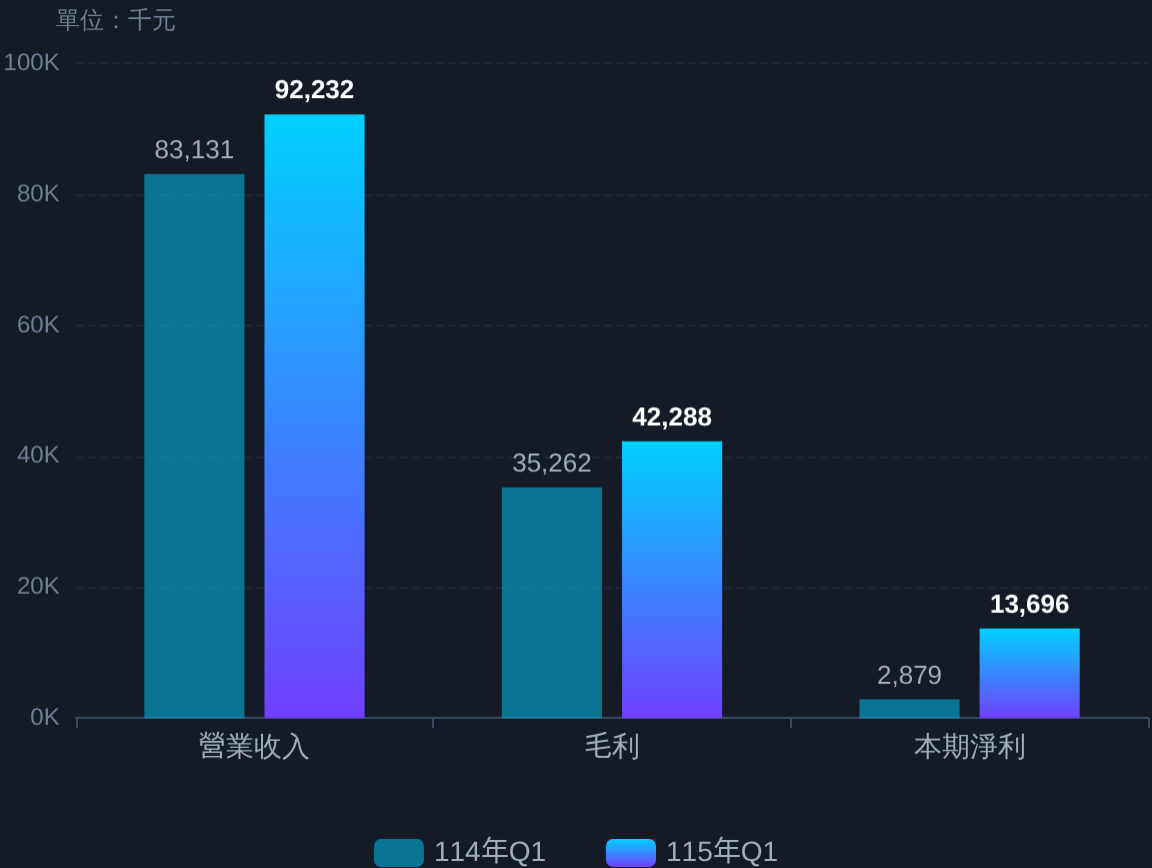
0.37 **+363% YoY**

- 本期淨利 13,696 千元，淨利率達 15%。
- 每股盈餘 EPS 由 0.08 元 成長至 0.37 元。

季度獲利能力顯著提升，展現強勁營運槓桿

115年第一季財務成果

第一季關鍵財務指標 YoY 對比 (千元)



財務指標 (第一季)	114年Q1	115年Q1
營業收入 (千元)	83,131	92,232
毛利率	42%	46% ▲
營業利益率	-2%	+12% ▲
稅後淨利率	3%	15% ▲

Q1 全面扭轉・獲利能力躍升EPS +363%

115年Q1各關鍵指標均優於去年同期：營收年增10.9%、毛利率提升4個百分點、營業利益率由 -2% 大幅改善至 +12%，成功扭轉虧損。

▲ 展望說明：Q1強勁獲利奠定全年基礎；下半年訂單集中交機，全年業績能見度高。

接單現況與市場結構



2026年訂單動能（已確認+LOI）

49筆 已確認 35 / LOI 14

● 已接單 (確認訂單)

35 筆

件數佔比 71.4%，訂單結構穩固

● LOI (意向書)

14 筆

件數佔比 28.6%，下半年轉單關鍵



接單時間分佈

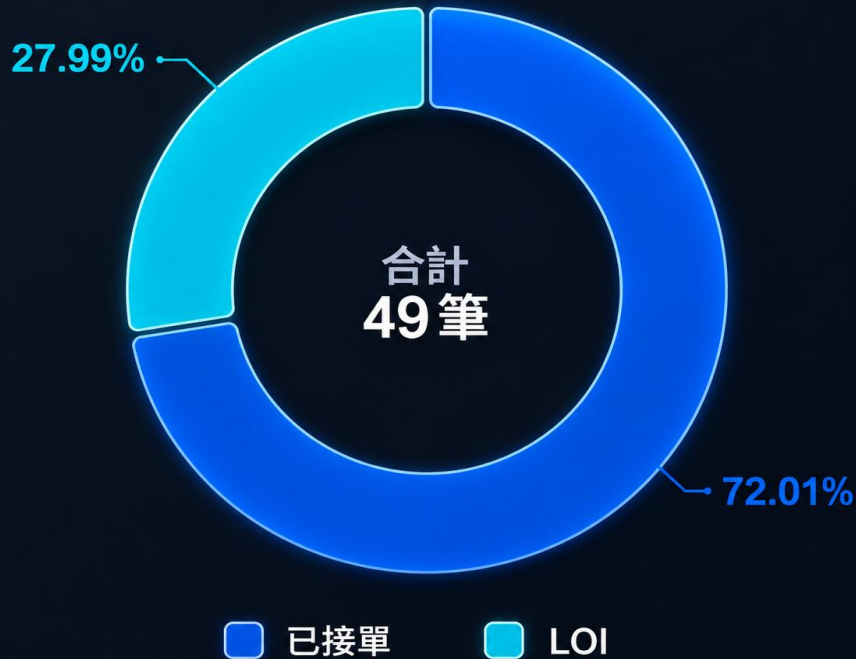
2026年1-4月為密集成交期，反映下游載板廠年初強烈擴產需求。最早接單可追溯至2025年7月。



LOI 轉單潛力

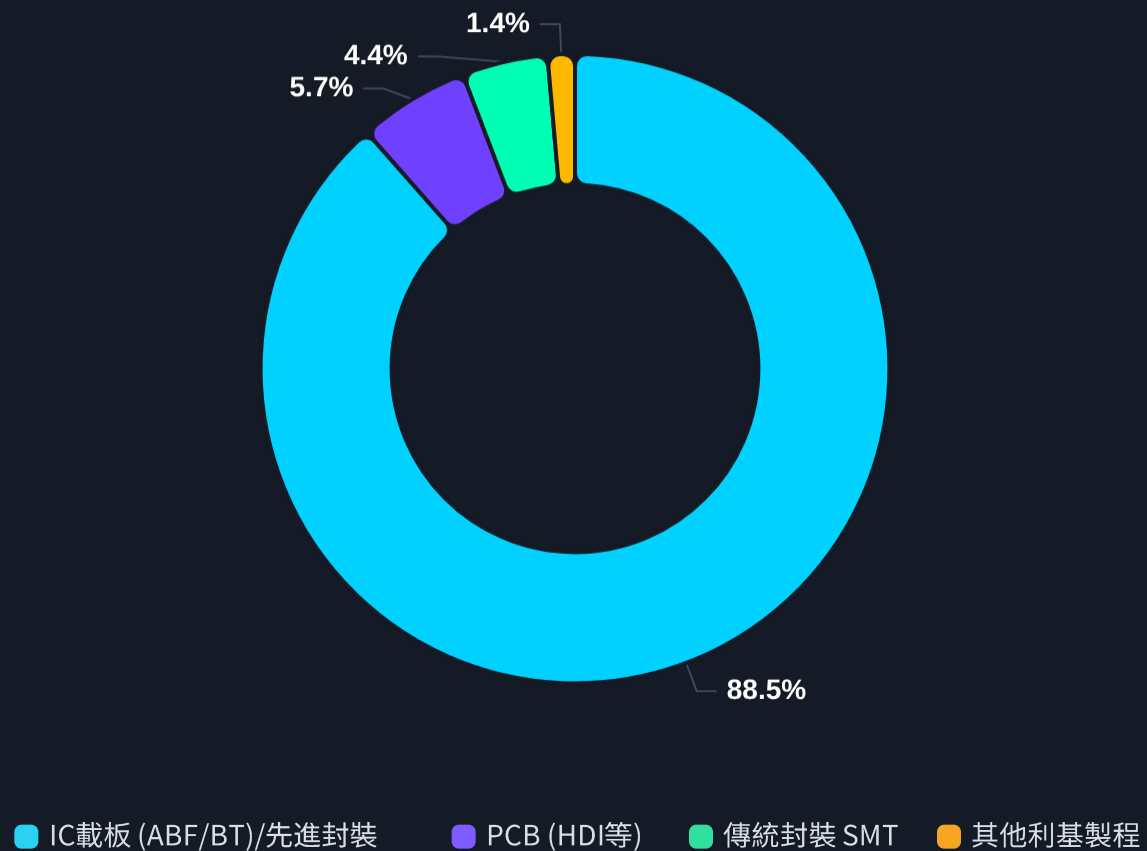
14筆意向書為下半年業績轉換關鍵；LOI案件若全數轉單，將顯著強化全年業績動能，降低訂單集中風險。

金額佔比分析



接單現況與市場結構

2026年訂單產業別結構佔比 (%)



IC 載板 (ABF/BT) /先進封裝佔比

88.5%

累積 38 項驗證案件

核心洞察：

反映暉盛科技在高端載板/先進封裝設備市場具備強大競爭力，Flip Chip 製程需求高度集中。

接單現況與市場結構

成熟規模市場：營運量體基石

中國大陸 (Mainland China) 49.0 %

案件數：30件。

台灣本土 (Taiwan) 16.1 %

案件數：15件。

東南亞 (Southeast Asia) 3.4 %

案件數：1件。

中國大陸 49.0%

台灣本土 16.1%

東南亞 3.4%

高價值戰略市場：技術領先指標

日本市場 (Japan) 31.5 %

案件數：3件。

RIE 旗艦系列

高附加價值機型，RIE 系列毛利結構優異，為公司整體獲利能力之重要支柱，帶動每台附加服務及維修收入可觀成長。

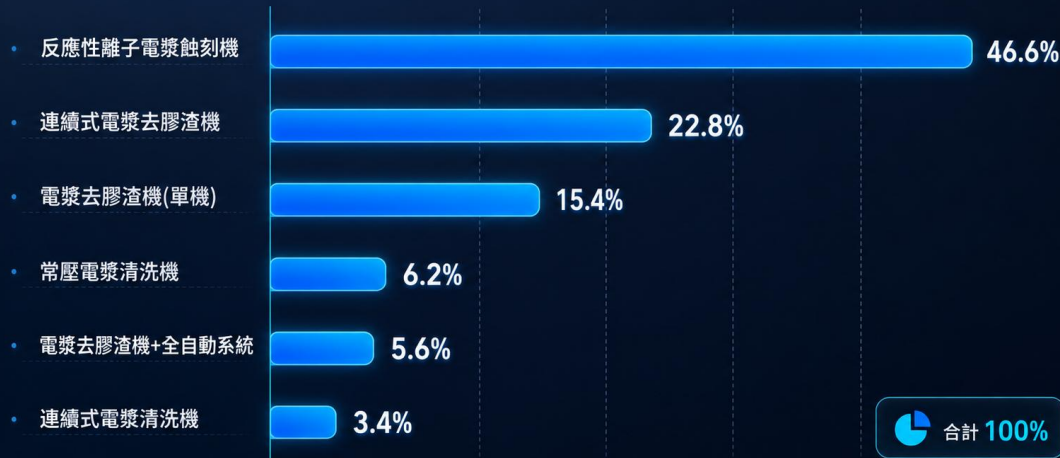
日本 31.5%

接單現況與市場結構

核心設備機型佔比分析

INVESTOR CONFERENCE 2026 | 暉盛科技

產品佔比分析



RIE 系列 (高單價旗艦)

46.6% (訂單結構佔比)

Desmear 系列 (高量體主力)

38.2% | 穩居市場佔有率



維修服務成長動能

+60.4% YoY 營收成長

隨全球安裝機台基數 (Install Base) 持續擴大，維修服務提供穩定且高頻率的重複性現金流。

115年1-5月維修收入佔比達 31.8%，較去年同期 15.8% 大幅成長



LOI 轉單與新機型趨勢

78% 意向書機型集中度

14 筆 LOI 中有 11 筆鎖定高階演進機型，反映市場對先進封裝技術更新的強烈需求。

NEMST-D2002ILDV 為下半年成長關鍵

未來展望與投資價值

引領電漿乾式製程革命，精密卡位 AI 算力與下世代玻璃基板封裝之全球核心價值鏈。



AI/HPC CORE

AI 算力鏈核心

ABF 載板電漿製程為 AI 伺服器晶片封裝不可或缺之環節，需求隨算力建設正向同步成長。



DRY ONLY

乾式取代趨勢

BT Desmear 與 Hybrid Bonding 去氧化等多項關鍵製程已成功取代濕式藥水，具備排他性優勢。



GLASS SUBSTRATE

下世代領航者

累計 7 項 TGV/玻璃基板驗證案件，建立全製程覆蓋能力，率先卡位下世代封裝材料商機。



DIVERSIFICATION

跨市場多元佈局

並行佈局 AI 伺服器、異質整合、電動車 Power Module 及 E-Chuck 再生，降低單一市場波動風險。



HIGH BARRIER

高技術護城河

每項應用均需 6-18 個月共同驗證，一旦導入 Recipe 即具備極高客戶黏著度與轉換成本。

重要聲明



資料來源與性質

本簡報資料係由暉盛科技股份有限公司提供之技術文件及財務資料彙整，僅供法人投資者及研究人員參考之用，不構成任何投資建議或要約。



技術與驗證說明

簡報所列應用案件為目前技術合作及驗證記錄，實際量產訂單轉換時程視各客戶製程驗收進度而定。接單金額等係依據業務記錄而非財務預測。



前瞻性陳述風險： 未來前瞻性描述涉及不確定性，實際結果可能與本簡報所述有所差異。簡報中之趨勢說明及百分比係依據訂單入帳排程資料，不代表公司對未來財務表現之保證。



版權歸屬與傳播限制

本簡報版權歸屬暉盛科技股份有限公司所有。未經本公司書面授權，不得以任何形式進行轉載、修改、對外散布或用於其他商業用途。